

**ADHESIVE FILM, ITS PRODUCTION, AND METHOD FOR ADHESION**

Patent Number: JP6264035  
Publication date: 1994-09-20  
Inventor(s): TAKEDA SHINJI; others: 03  
Applicant(s):: HITACHI CHEM CO LTD  
Requested Patent: ☐ JP6264035  
Application Number: JP19930055601 19930316  
Priority Number(s):  
IPC Classification: C09J7/00 ; C08G59/40 ; C08G73/10 ; C09J7/02 ; C09J163/00  
EC Classification:  
Equivalents: JP2964823B2

**Abstract**

**PURPOSE:** To prepare an adhesive film for die bonding which, like a conventional silver paste, enables the heat treatment in die bonding to be carried out at a relatively low temp.  
**CONSTITUTION:** This adhesive film contains 100 pts.wt. polyimide resin obtd. by reacting a diamine with a tetracarboxylic dianhydride component contg. at least 70mol% tetracarboxylic dianhydride of the formula (wherein (n) is an integer of 2-20), 1-200 pts.wt. epoxy resin, 0.02-240 pts.wt. phenol resin, 0.0001-100 pts.wt. cure accelerator, and 50-4,000 pts.wt. inorg. filler.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

甲才2号証  
(P3117966)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-264035

(43)公開日 平成6年(1994)9月20日

(51)Int.Cl. <sup>8</sup>	鑑別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 9 J 7/00	J H K	6904-4 J		
C 0 8 G 59/40	N J E	8416-4 J		
73/10	N T F	9285-4 J		
C 0 9 J 7/02	J K E	6904-4 J		
	J L E	6904-4 J		

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 7 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号	特願平5-55601	(71)出願人	000004455 日立化成工業株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号
(22)出願日	平成5年(1993)3月16日	(72)発明者	武田 信司 茨城県つくば市和台48番 日立化成工業株式会社筑波開発研究所内
		(72)発明者	湯佐 正己 茨城県つくば市和台48番 日立化成工業株式会社筑波開発研究所内
		(72)発明者	増子 崇 茨城県つくば市和台48番 日立化成工業株式会社筑波開発研究所内
		(74)代理人	弁理士 若林 邦彦 最終頁に続く

(54)【発明の名称】 接着フィルム、その製造法及び接着法

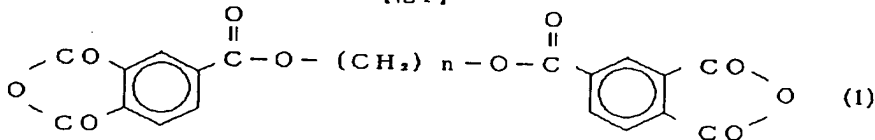
(57)【要約】

【目的】 ダイボンド時の熱処理を従来の銀ペーストと同じように比較的低温で行うことのできる、ダイボント用の接着フィルムを提供する。

【構成】 (A) 式 (I) (式 (I) 中、n は 2 ~ 20 の整数を示す。) で表されるテトラカルボン酸二無水物が、全酸二無水物に対し 70 モル%以上含まれるテトラ

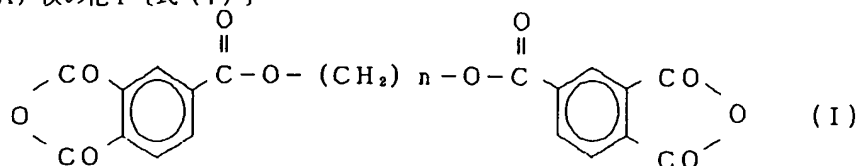
カルボン酸二無水物に、ジアミンを反応させて得られるポリイミド系樹脂 100 重量部； (B) エポキシ樹脂 1 ~ 200 重量部； (C) フェノール樹脂 0.02 ~ 240 重量部； (D) 硬化促進剤 0.0001 ~ 100 重量部；及び (E) 無機物質フィラー 50 ~ 4000 重量部、を含有してなる接着フィルム。

【化1】



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 次の化1【式(1)】



(ただし、 $n = 2 \sim 20$ の整数を示す。)で表されるテトラカルボン酸二無水物が、全酸二無水物に対し70モル%以上含まれるテトラカルボン酸二無水物に、ジアミンを反応させて得られるポリイミド系樹脂；

(B) エポキシ樹脂；

(C) フェノール樹脂；

(D) 硬化促進剤；及び

(E) 無機物質フィラー、を含有してなる接着フィルム。

【請求項2】 (A) 式(1)で表されるテトラカルボン酸二無水物が、全酸二無水物に対し70モル%以上含まれるテトラカルボン酸二無水物に、ジアミンを反応させて得られるポリイミド系樹脂

(B) エポキシ樹脂；及び

(C) フェノール樹脂；を有機溶媒に溶解し、これに

(D) 硬化促進剤；及び

(E) 無機物質フィラー、を加え、混合し、ベースフィルム上に塗布したのち、加熱することを特徴とする請求項1の接着フィルムの製造法。

【請求項3】 半導体素子と支持部材の間に請求項1の接着フィルムを挟み、加熱圧着することを特徴とする半導体素子と支持部材との接着法。

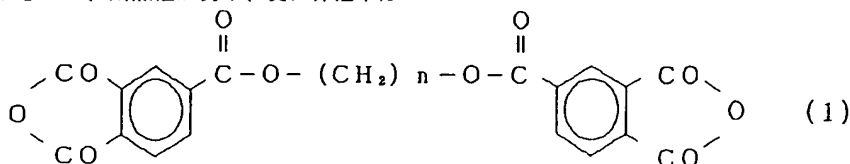
## 【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、ICやLSIとリードフレームの接合材料、すなわちダイボンディング用材料として用いられる接着フィルム、その製造法及び接着法に関する。

【0002】

【従来の技術】 従来、ICやLSIとリードフレームの接合にはAu-Si共晶合金、半田あるいは銀ペースト等が用いられている。Au-Si共晶合金は、耐熱性及び耐湿性は高いが、弾性率が大きい大型チップへ適用した場合に割れやすいほか、高価である難点がある。半田は安価であるものの、耐熱性が劣り、更に弾性率は



(ただし、 $n = 2 \sim 20$ の整数を示す。)で表されるテトラカルボン酸二無水物が全酸二無水物に対し70モル%以上含まれるテトラカルボン酸二無水物に、ジアミン

【化1】

Au-Si共晶合金と同様に高く、大型チップへ適用が困難である。一方、銀ペーストは安価で、耐湿性が高く、弾性率も上記3者の中では最も低く、350℃の熱圧着型ワイヤボンダーに適用できる耐熱性も有するので、現在のICやLSIとリードフレームの接合用材料の主流となっている。しかし、近年ICやLSIの高集積化が進み、それに伴ってチップが大型化しているなかで、ICやLSIとリードフレームを銀ペーストで接合しようとする場合、銀ペーストをチップ全面に広げ塗布するには困難を伴う。

【0003】 マイクロエレクトロニック マニファクチャリング アンド テスティング (MICROELECTRONIC MANUFACTURING AND TESTING 1988年6月、9頁)に、金属フィラーを熱可塑性樹脂に充填したダイボンド用の接着フィルムが開示された。これは熱可塑性樹脂の融点付近まで温度を上げ、加圧接合するものである。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 上記雑誌に開示された接着フィルムは、融点が低い熱可塑性樹脂を用いると接合温度が低くなり、リードフレームの酸化等、チップに与えるダメージは少なくすむ。しかし、耐熱性が低いのでダイボンド後の熱処理、例えばワイヤボンド、封止工程等に耐えられない。そのような熱処理に耐えられるように融点の高い熱可塑性樹脂を用いると、接合温度が高くなり、リードフレームの酸化等のダメージを受ける問題がある。本発明は、ダイボンド時の熱処理を従来の銀ペーストと同じように比較的低温で行うことのできる、ダイボンド用の接着フィルムを提供することを目的としている。

【0005】

【課題を解決するための手段】 本発明は、次の(1)～(3)に関する。

(1)

(A) 次の化2【式(1)】

【化2】

を反応させて得られるポリイミド系樹脂；

(B) エポキシ樹脂；

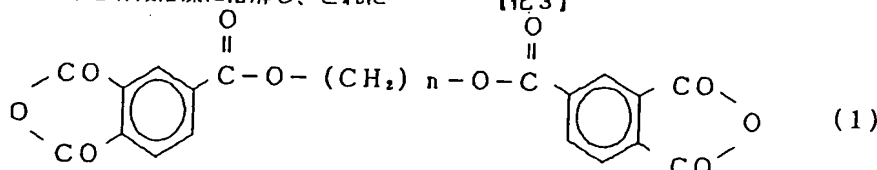
(C) フェノール樹脂；

(D) 硬化促進剤；及び

(E) 無機物質フィラー、を含有してなる接着フィルム。

(2) (A) 式(1)で表されるテトラカルボン酸二無水物が、全酸二無水物に対し70モル%以上含まれるテトラカルボン酸二無水物に、ジアミンを反応させて得られるポリイミド系樹脂、(B) エポキシ樹脂；及び

(C) フェノール樹脂；を有機溶媒に溶解し、これに



(ただし、 $n=2\sim 20$ の整数を示す。)で表されるテトラカルボン酸二無水物が全酸二無水物に対し70モル%以上含まれるテトラカルボン酸二無水物に、ジアミンを反応させて得られるポリイミド系樹脂、が用いられる。

【0006】本発明で用いるエポキシ樹脂(B)は、分子内に少なくとも2個のエポキシ基を含むもので、硬化性や硬化物特性の点からフェノールのグリシジルエーテル型のエポキシ樹脂が好ましく用いられる。このような樹脂としては、ビスフェノールA、ビスフェノールA D、ビスフェノールS、ビスフェノールFもしくはハロゲン化ビスフェノールAとエピクロロヒドリンの縮合物、フェノールノボラック樹脂のグリシジルエーテル、クレゾールノボラック樹脂のグリシジルエーテル、ビスフェノールAノボラック樹脂のグリシジルエーテル等が挙げられる。エポキシ樹脂の量は、ポリイミド樹脂100重量部に対して1~200重量部、好ましくは5~100重量部の範囲でこれより少ないと接着性が悪くなり、多いとフィルム形成性が劣る。

【0007】本発明で用いるフェノール樹脂(C)は、分子中に少なくとも2個のフェノール性水酸基を有するもので、このような樹脂としては例えば、フェノールノボラック樹脂、クレゾールノボラック樹脂、ビスフェノールAノボラック樹脂、ポリ-p-ビニルフェノール、フェノールアラールキル樹脂等が挙げられる。フェノール樹脂の量は、エポキシ樹脂100重量部に対して2~150重量部、好ましくは50~120重量部の範囲で、これより多くても少なくても硬化性が不充分となる。

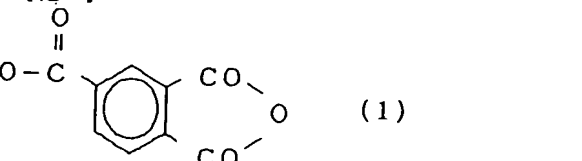
【0008】本発明で用いる硬化促進剤(D)は、エポキシ樹脂を硬化させるために用いられるものであれば特に制限はない。このようなものとしては例えば、イミダゾール類、ジシアンジアミド誘導体、ジカルボン酸ジヒドラジド、トリフェニルホスフィン、テトラフェニルホスホニウムテトラフェニルボレート、2-エチル-4-メチルイミダゾール-テトラフェニルボレート、1,8-ジアザピンクロ(5,4,0)ウンデセン-7-テトラフェニルボレート等が用いられる。これらは、2種以

(D) 硬化促進剤；及び(E) 無機物質フィラー、を加え、混合し、ベースフィルム上に塗布したのち、加熱することを特徴とする接着フィルムの製造法。

(3) 半導体素子と支持部材の間に上記(1)の接着フィルムを挟み、加熱圧着する、半導体素子と支持部材との接着法。

本発明で用いるポリイミド樹脂は、

【化3】



上を併用してもよい。硬化促進剤の量はエポキシ樹脂100重量部に対し、0.01~50重量部、好ましくは0.1~20重量部の範囲で、これより少ないと硬化性が不充分となり、多いと保存安定性が悪くなる。

【0009】本発明で用いる無機物質フィラー(E)は、接着剤に低熱膨張性、低吸湿率を付与する目的で添加されるものであり、シリカ、アルミナ、チタニア、ガラス、酸化鉄、セラミック等の無機絶縁体を単独又は2種以上混合して用いる。無機物質フィラーの量は、ポリイミド樹脂100重量部に対し1~8000重量部、好ましくは50~4000重量部の範囲である。これよりも少ないと充分な低熱膨張性、低吸湿性が得られず、これよりも多いと接着性が低下する。

【0010】本発明で用いる、式(1)で表されるテトラカルボン酸二無水物としては、エチレンビストリメリテート二無水物、トリメチレンビストリメリテート二無水物、テトラメチレンビストリメリテート二無水物、ペンタメチレンビストリメリテート二無水物、ヘキサメチレンビストリメリテート二無水物、ヘプタメチレンビストリメリテート二無水物、オクタメチレンビストリメリテート二無水物、ノナメチレンビストリメリテート二無水物、デカメチレンビストリメリテート二無水物、ドデカメチレンビストリメリテート二無水物、ヘキサデカメチレンビストリメリテート二無水物、オクタデカメチレンビストリメリテート二無水物等があり、2種以上を併用してもよい。

【0011】これらのテトラカルボン酸二無水物は、無水トリメリット酸モノクロライド及び対応するジオールから合成することができる。上記テトラカルボン酸二無水物は、全テトラカルボン酸二無水物に対し70モル%以上を含むものである。70モル%未満であると、接着フィルムの接合時の温度が高くなり好ましくない。

【0012】式(1)のテトラカルボン酸二無水物と共に使用できるテトラカルボン酸無水物としては、例えば、ピロメリット酸二無水物、3,3',4,4'-ジフェニルテトラカルボン酸二無水物、2,2',3,3'-ジフェニルテトラカルボン酸二無水物、2,2'-

ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)プロパン二無水物、2,2-ビス(2,3-ジカルボキシフェニル)プロパン二無水物、1,1-ビス(2,3-ジカルボキシフェニル)エタン二無水物、1,1-ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)エタン二無水物、ビス(2,3-ジカルボキシフェニル)メタン二無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)メタン二無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)スルホン二無水物、3,4,9,10-ペリレンテトラカルボン酸二無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)エーテル二無水物、ベンゼン-1,2,3,4-テトラカルボン酸二無水物、3,4,3',4'-ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、2,3,2',3'-ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、2,3,3',4'-ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、1,2,5,6-ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、2,3,6,7-ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、1,2,4,5-ナフタレン-テトラカルボン酸二無水物、1,4,5,8-ナフタレン-テトラカルボン酸二無水物、

【0013】2,6-ジクロルナフタレン-1,4,5,8-テトラカルボン酸二無水物、2,7-ジクロルナフタレン-1,4,5,8-テトラカルボン酸二無水物、2,3,6,7-テトラクロルナフタレン-1,4,5,8-テトラカルボン酸二無水物、フェナンスレン-1,8,9,10-テトラカルボン酸二無水物、ピラジン-2,3,5,6-テトラカルボン酸二無水物、チオフェン-2,3,4,5-テトラカルボン酸二無水物、2,3,3',4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、3,4,3',4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、2,3,2',3'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)ジメチルシラン二無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)メチルフェニルシラン二無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)ジフェニルシラン二無水物、1,4-ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)ジメチルシリル)ベンゼン二無水物、1,3-ビス

(3,4-ジカルボキシフェニル)-1,1,3,3-テトラメチルジシクロヘキサン二無水物、p-フェニルビス(トリメリット酸モノエステル酸無水物)、

【0014】エチレンテトラカルボン酸二無水物、1,2,3,4-ブタンテトラカルボン酸二無水物、デカヒドロナフタレン-1,4,5,8-テトラカルボン酸二無水物、4,8-ジメチル-1,2,3,5,6,7-ヘキサヒドロナフタレン-1,2,5,6-テトラカルボン酸二無水物、シクロペンタン-1,2,3,4-テトラカルボン酸二無水物、ピロリジン-2,3,4,5-テトラカルボン酸二無水物、1,2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸二無水物、ビス(エキソ-ビスシクロ(2,2,1)ヘプタン-2,3-ジカルボン酸無水物)スルホン、ビスシクロ(2,2,2)オクト

(7)-エン2,3,5,6-テトラカルボン酸二無水物、2,2-ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)ヘキサフルオロプロパン二無水物、2,2-ビス[4-(3,4-ジカルボキシフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン二無水物、4,4'-ビス(3,4-ジカルボキシフェノキシ)ジフェニルスルフィド二無水物、1,4-ビス(2-ヒドロキシヘキサフルオロイソプロピル)ベンゼンビス(トリメリット酸無水物)、1,3-ビス(2-ヒドロキシヘキサフルオロイソプロピル)ベンゼンビス(トリメリット酸無水物)、5-(2,5-ジオキソテトラヒドロフリル)-3-メチル-3-シクロヘキセン-1,2-ジカルボン酸無水物、テトラヒドロフラン-2,3,4,5-テトラカルボン酸二無水物等があり、2種類以上を混合して用いてもよい。

【0015】本発明で使用するジアミンとしては、1,2-ジアミノエタン、1,3-ジアミノプロパン、1,4-ジアミノブタン、1,5-ジアミノペンタン、1,6-ジアミノヘキサン、1,7-ジアミノヘプタン、1,8-ジアミノオクタン、1,9-ジアミノノナン、1,10-ジアミノデカン、1,11-ジアミノウンデカン、1,12-ジアミノドデカン等の脂肪族ジアミン、o-フェニレンジアミン、m-フェニレンジアミン、p-フェニレンジアミン、3,3'-ジアミノジフェニルエーテル、3,4'-ジアミノジフェニルエーテル、4,4'-ジアミノジフェニルエーテル、3,3'-ジアミノジフェニルメタン、3,4'-ジアミノジフェニルメタン、4,4'-ジアミノジフェニルメタン、3,3'-ジアミノジフェニルジフルオロメタン、3,4'-ジアミノジフェニルジフルオロメタン、4,4'-ジアミノジフェニルジフルオロメタン、3,3'-ジアミノジフェニルスルホン、3,4'-ジアミノジフェニルスルホン、4,4'-ジアミノジフェニルスルホン、3,3'-ジアミノジフェニルスルフィド、3,4'-ジアミノジフェニルスルフィド、4,4'-ジアミノジフェニルスルフィド、

【0016】3,3'-ジアミノジフェニルケトン、3,4'-ジアミノジフェニルケトン、4,4'-ジアミノジフェニルケトン、2,2-ビス(3-アミノフェニル)プロパン、2,2'-bis(3,4'-ジアミノジフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-アミノフェニル)プロパン、2,2-ビス(3-アミノフェニル)ヘキサフルオロプロパン、2,2-bis(3,4'-ジアミノジフェニル)ヘキサフルオロプロパン、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,4-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、3,3'-bis(1,4-フェニレンビス(1-メチルエチリデン))ビスアニリン、3,4'-bis(1,4-フェニレンビス(1-メ

チルエチリデン) ) ビスアニリン、4, 4' - (1, 4-フェニレンビス (1-メチルエチリデン) ) ビスアニリン、2, 2-ビス (4- (3-アミノフェノキシ) フェニル) プロパン、2, 2-ビス (4- (4-アミノフェノキシ) フェニル) プロパン、2, 2-ビス (4- (3-アミノフェノキシ) フェニル) ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス (4- (4-アミノフェノキシ) フェニル) ヘキサフルオロプロパン、ビス (4- (3-アミノフェノキシ) フェニル) スルフィド、ビス (4- (4-アミノフェノキシ) フェニル) スルフィド、ビス (4- (3-アミノフェノキシ) フェニル) スルホン、ビス (4- (4-アミノフェノキシ) フェニル) スルホン、3, 3'-ジメトキシ-4, 4'-ジアミノビフェニル、4, 4'-メチレン-ビス (2, 6-ジエチルアニリン) 、o-トリジンスルホン、1, 4-ビス (4-アミノフェノキシ) ベンゼン、4, 4'-メチレン-ビス (2, 6-ジイソプロピルアニリン) 、4, 4'-ビス (4-アミノフェノキシ) ビフェニル、1, 1-ビス (4- (4-アミノフェノキシ) フェニル) シクロヘキサン、1, 3-ビス (3-アミノプロピル) テトラメチルジシロキサン等の芳香族ジアミンを挙げることができる。

【0017】テトラカルボン酸二無水物とジアミンの縮合反応は、有機溶媒中で行う。この場合、テトラカルボン酸二無水物とジアミンは等モル又はほぼ等モルで用いるのが好ましく、各成分の添加順序は任意である。用いる有機溶媒としては、ジメチルアセトアミド、ジメチルホルムアミド、N-メチル-2-ピロリドン、ジメチルスルホキシド、ヘキサメチルホスホリアルアミド、m-クレゾール、o-クロルフェノール等がある。

【0018】反応温度は80℃以下、好ましくは0～50℃である。反応が進行するにつれ反応液の粘度が徐々に上昇する。この場合、ポリイミドの前駆体であるポリアミド酸が生成する。

【0019】ポリイミド樹脂は、前記反応物 (ポリアミド酸) を脱水閉環させて得ることができる。脱水閉環は120℃～250℃で熱処理する方法や化学的方法を用いて行うことができる。120℃～250℃で熱処理する方法の場合、脱水反応で生じる水を系外に除去しながら行うことが好ましい。この際、ベンゼン、トルエン、キシレン等を用いて水を共沸除去してもよい。

【0020】化学的方法で脱水閉環させる場合は、閉環剤として無水酢酸、無水プロピオン酸、無水安息香酸の酸無水物、ジシクロヘキシルカルボジイミド等のカルボジイミド化合物等を用いる。このとき必要に応じてピリジン、イソキノリン、トリメチルアミン、アミノピリジン、イミダゾール等の閉環触媒を用いてもよい。閉環剤又は閉環触媒は、テトラカルボン酸二無水物1モルに対し、それぞれ1～8モルの範囲で使用するのが好ましい。

【0021】また、本発明の接着フィルムに、必要に応じてシランカップリング剤、チタン系カップリング剤、ノニオン系界面活性剤、フッ素系界面活性剤、シリコン系添加剤等を適宜加えてもよい。

【0022】本発明の接着フィルムの製造は、以下のようにする。まずエポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリイミド系樹脂を有機溶媒に溶解する。ここで用いられる有機溶媒は、上記材料を均一に溶解又は混練できるものであれば特に制限はなく、そのようなものとしては例えば、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、N-メチルピロリドン、ジメチルスルホキシド、ジエチレングリコールジメチルエーテル、トルエン、ベンゼン、キシレン、メチルエチルケトン、テトラヒドロフラン、エチルセロソルブ、エチルセロソルブアセテート、ブチルセロソルブ、ジオキサン等が挙げられる。

【0023】次いで、硬化促進剤、無機物質フィラー及び必要に応じ添加剤を加え、混合する。この場合、通常の攪拌機、らいかい機、三本ローラー、ボールミルなどの分散機を適宜組み合わせて、混練を行ってもよい。

【0024】こうして得たペースト状混合物を、例えばプロピレン製シート等のベースフィルム上に均一に塗布し、使用した溶媒が充分に揮散する条件、すなわち、おおむね60～200℃の温度で、0.1～30分間加熱し、接着フィルムを得る。

【0025】本発明で得られた接着フィルムは、IC、LSI等の半導体素子のリードフレーム、セラミックス配線板、ガラスエポキシ配線板、ガラスポリイミド配線板の支持部材の接着に用いられる。

【0026】本発明の接着フィルムは、例えば、ICやLSI等の半導体素子とリードフレームとを接着する場合、次の様な方法で接着することができる。

【0027】第一に、接着フィルムをテープリボン状に形成し、これを半導体素子の大きさに合わせて切断し、リードフレームと半導体素子の間に挟み込んで、加熱接着させる方法がある。この方法で接着する場合には、例えば半田リボン用のダイボンディング装置等を応用した装置で接着させることができる。

【0028】第二に、接着フィルムをまずリードフレームに形成しておき、次に半導体素子を加熱接着させる方法がある。リードフレームに接着フィルムを形成するには、接着フィルムを半導体素子の大きさに合わせて切断し、加熱して貼り付ける方法あるいは溶媒を塗布して貼り付ける方法等がある。また、接着フィルムのワニスをリードフレーム上に印刷塗布する方法で形成させることもできる。リードフレームに接着フィルムを形成した後、半導体素子を接着するには、例えば、従来、銀ペーストで用いられていたダイボンディング装置等を応用した装置で接着させることができる。

【0029】第三に、接着フィルムをウェハ裏面に形成しておき、次にダイシング工程でウェハ及び接着フィル

ムを切断し、リードフレームに接着する方法がある。ウェハ裏面に接着フィルムを形成するには、接着フィルムを加熱して貼り付ける方法あるいは溶媒を塗布して貼り付ける方法等がある。また、接着フィルムのワニスウェハ裏面に印刷塗布あるいはスピンコートする方法で形成させることもできる。ウェハ裏面に接着フィルムを形成した後、半導体素子を接着するには、例えば、従来、銀ペーストで用いられていたダイボンディング装置等を応用した装置で接着させることができる。

【0030】上記の方法の他に、ダイシング工程で用いられる粘着性のダイシングフィルムの上に、接着フィルムを形成させておき、これにウェハを貼り付けた後、ダイシング工程で半導体素子と接着フィルムを切断し、リードフレームに貼り付ける方法等があるが、本発明の接着フィルムは、上記に例示したいずれの方法に限定されるものではない。

#### 【0031】

【実施例】以下、本発明を実施例を用いて説明する。

#### 合成例1

温度計、攪拌機及び塩化カルシウム管を備えた500mlの四つ口フラスコに、2, 2-ビス(4-アミノフェノキシ)フェニル)プロパン41g(0.1mol)及びジメチルアセトアミド150gをとり、攪拌した。ジアミンの溶解後、フラスコを氷浴中で冷却しながら、エチレンビストリメリテート二無水物41g(0.1mol)を少量ずつ添加した。室温で3時間反応させたのち、キシレン30gを加え、N<sub>2</sub>ガスを吹き込みながら150℃で加熱し、水と共にキシレンを共沸除去した。その反応液を水中に注ぎ、沈殿したポリマーを濾過により採り、乾燥してポリイミドAを得た。

#### 【0032】合成例2

温度計、攪拌機及び塩化カルシウム管を備えた500mlの四つ口フラスコに、4, 4'-メチレンビス(2, 6-ジイソプロピルアニリン)32.94g(0.09mol)、1, 3-ビス(3-アミノプロピル)テトラメチルジシロキサン2.48g(0.01mol)及びN-メチル-2-ピロリドン150gをとり、攪拌した。ジアミンの溶解後、室温で、テトラメチレンビストリメリテート二無水物43.8g(0.1mol)

を加えた。5℃以下で5時間反応させ、無水酢酸20.4g(0.2mol)及びピリジン15.8g(0.2mol)を加え、1時間室温で攪拌した。この反応液を水中に注ぎ、沈殿したポリマーを濾過により採り、乾燥してポリイミドBを得た。

#### 【0033】合成例3

温度計、攪拌機、塩化カルシウム管を備えた500mlの四つ口フラスコに、2, 2-ビス(4-アミノフェノキシフェニル)プロパン32.8g(0.08mol)、3, 3', 5, 5'-テトラメチル-4, 4'-ジアミノジフェニルメタン5.08g(0.02mol)及びジメチルアセトアミド100gをとり、攪拌した。ジアミンの溶解後、フラスコを氷浴中で冷却しながら、デカメチレンビストリメリテート二無水物41.8g(0.08mol)及びベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物6.44g(0.02mol)を少量ずつ添加した。添加終了後、氷浴中で3時間、更に室温で4時間反応させた後、無水酢酸25.5g(0.25mol)及びピリジン19.8g(0.25mol)を添加し、2時間室温で攪拌した。その反応液を水中に注ぎ、沈殿したポリマーを濾過により採り、乾燥してポリイミドCを得た。

#### 【0034】実施例1~5

表1の配合表に示す通り、No. 1~7(本発明の実施例: No. 1~5、比較例: No. 6~7)のワニスを調合した。なお、表1において、種々の記号は下記のことを意味する。

YDCH-702: 東都化成、クレゾールノボラック型エポキシ(エポキシ当量220)

N-865: 大日本インキ製、ビスフェノールノボラック型エポキシ(エポキシ当量208)

ESCN-195: 住友化学、クレゾールノボラック型エポキシ(エポキシ当量200)

H-1: 明和化成、フェノールノボラック(OH当量106)

VH-4170: 大日本インキ、ビスフェノールAノボラック(OH当量118)

#### 【0035】

【表1】

表1 配合表

(単位: 重量部)

	No. 1	2	3	4	5	6	7
ポリイミド	A	B	C	A	A	—	A
	100	100	100	100	100		100
エポキシ樹脂	YDCN-702	N-865	ESCN-195	N-865	N-865	YDCN-702	—
	50部	20部	10部	10部	100部	100部	—

フェノー ル樹脂	H-1 24	H-1 10	VII-4170 5.9	VII-4170 5.6	VII-4170 70	H-1 48	—
硬化促進 剤	2P4MHZ 0.5	TPPK 0.4	2MA-OK 0.1	TPPK 0.5	TPPK 10	2P4MHZ 1	—
無機物質 フィラー	シリカ 80	シリカ 45	シリカ 18	アルミナ 100	アルミナ 190	シリカ 180	シリカ 180
溶 媒	DMAC 400	NMP 200	DMF 100	DMF 100	DMF 1000	DMAC 1000	DMAC 500

ただし、表1中の記号は、下記の意味である。

DMAC：ジメチルアセトアミド

NMP：N-メチルピロリドン

DMF：ジメチルホルムアミド

このワニスを30～50 $\mu$ mの厚さにポリプロピレンフィルム上に塗布し、80℃で10分、つづいて120℃で30分加熱し、接着フィルムを得た。

【0036】次に、得られた接着フィルムの接着力を試

験した。接着フィルムを4×4mmの大きさに切断し、これを4×4mmのシリコンチップと銀メッキ付42アロリードフレームの間に挟み、1000gの荷重をかけて、260℃、3秒間圧着させたのち、剪断接着力をプッシュプルゲージを用いて、室温時及び350℃加熱20秒後の熱時に、接着力を測定した(表2)。

【0037】

【表2】

表2 ペーストのフィルム成型性及び接着フィルムの接着力

		*1						
		No. 1	2	3	4	5	6 (比較)	7 (比較)
接着力 (kg/chip)	室温	10.7	11.0	11.5	10.3	14.0	—	11.0
	350℃	2.2	2.4	3.2	2.0	2.3	—	0.4

\*1 胞いためフィルム状にならず、接着力を測定できなかった。

【0038】

【発明の効果】本発明の接着フィルムは、熱硬化性であるため熱時の接着性に優れている。本発明の接着フィル

ムを用いれば、ICやLSIの大型チップに均一に接着剤層を設けることが可能である。

フロントページの続き

(51)Int. Cl.<sup>5</sup>

C09J 163/00

// H01L 21/52

識別記号

JFP

庁内整理番号

8830-4J

E 7376-4M

FI

技術表示箇所

(72)発明者 宮寺 康夫

茨城県つくば市和台48番 日立化成工業株式会社筑波開発研究所内